

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 15 日 （周二）下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长 邱国良 总经理 邓迪 董事会秘书 邱靖琳 财务总监 谢学运 独立董事 严义 独立董事 谢园保
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、综合毛利率达 41.86，同比 9.58pct，主要由锡膏印刷设备占比提升和高端化驱动。在基板复杂度持续提高、AI 高端 PCB 需求增长的背景下，毛利率是否具备维持 40 的基础？锡膏印刷设备高端机型收入占比目标？ 答：您好！2026 年半年度公司综合毛利率为 40.61%，锡膏

	印刷设备实现营业收入 43,750.21 万元，同比增长 49.84%，主要原因系 AI 算力及高速通信等下游领域的高景气，PCBA 中 SMT 设备需求延续了增长态势。公司将不断巩固锡膏印刷设备单项冠军的市场地位，紧跟工艺技术变化，提升高端市场及高精密印刷市场的占有率，感谢您的关注！ 2、上半年封装设备收入同比-38.85，下半年 LED 需求回暖拐点何时出现？半导体封装业务（KGD 测试机、共晶机等）的客户验证进展、收入贡献节奏如何？ 答：您好！2026 年半年度，公司封装设备实现营业收入 16,257.00 万元，同比增长 174.72%，主要系公司产品经过研发的迭代升级之后，在客户端的使用成本、产出效率、品质管控等方面有较大的提升，获得了客户的认可，客户数量增长，提升了市场占有率。公司高精度固晶机赢得了下游通讯行业客户的认可，出货量稳步提升；多款封装设备成功切入 SIP、COB、COG、MiP 等细分领域。感谢您的关注！ 3、公司 800G 光模块自动化组装线体已获全球知名客户认可，1.6T 光模块自动化组装产品线新推出。该业务全年收入指引是多少？哪些头部客户？何时能形成继锡膏设备之后的第二增长曲线？ 答：您好！2026 年半年度，公司柔性自动化业务实现营业收入 3,363.56 万元，同比增长 37.22%，公司光模块自动化组装线持续出货。感谢您的关注！ 4、公司半年报显示锡膏印刷设备收入 4.38 亿元、同比增长 49.84，主要受益于 AI 算力及高速通信下游高景气。作为全球锡膏印刷设备龙头，请问 AI 服务器、高速交换机等下游的 SMT 设备需求持续性如何？公司在算力产业链的份额提升空间还有多大？ 答：您好！2026 年半年度，公司锡膏印刷设备实现营业收入
--	--

	43,750.21 万元，同比增长 49.84%，主要原因系 AI 算力及高速通信等下游领域的高景气，PCBA 中 SMT 设备需求延续了增长态势。公司将不断巩固锡膏印刷设备单项冠军的市场地位，紧跟工艺技术变化，提升高端市场及高精密印刷市场的占有率，感谢您的关注！ 5、上半年期间费率明显下降，归母净利率达 15.06。在收入规模扩张和提质增效持续推进下，全年净利率是否有望向 19 以上的历史高位靠拢？ 答：您好！公司上半年实现营业收入 7.33 亿元，同比增长 61.53%；归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增长 104.69%。公司上半年净利率为 18.95%。公司将继续聚焦主业、稳健经营，努力提升经营业绩的稳定性与可持续性。感谢您的关注！ 6、经营现金流净额由上年同期-1.07 亿元转为 612.77 万元。下游回款结构、客户付款条件、应收账款周转情况如何改善？全年经营现金流能否匹配净利润释放？ 答：您好！公司 2026 年半年度经营活动产生的现金流量净额为 1,152.33 万元，上年同期为 612.76 万元，同比实现增长 88.05%。公司将持续做好现金流管控，推动经营性现金流质量稳步提升。感谢您的关注！ 7、“公司前瞻布局了 3D 钢网印刷、植球等适配 CoWoS/CoWoP 工艺的关键技术。在当前全球先进封装产能极度紧缺的背景下，公司这些前沿储备技术目前的打样验证进度如何？未来在推动高端半导体封装设备商业化落地、打破海外垄断方面有何具体规划？这些高壁垒产品何时能转化为实际订单，从而为公司带来更高的估值溢价？” 答：您好！公司将持续加大对研发中心的投入，完善研发中心平台化的建设，深化研发人才梯队的培养，迭代升级产品
--	---

竞争力；加大市场推广力度，积极拓展新客户、新市场、新业务，提升新产品的市场占有率。感谢您的关注！

8、作为全球锡膏印刷设备的龙头企业，公司在 AI 算力基础设施扩容中获得了显著红利。面对 ASMPT、ITW 等国际巨头的竞争，公司在高端印刷设备领域的核心技术壁垒主要体现在哪里？未来在提升股份内在价值的过程中，公司将如何进一步巩固并扩大这一全球领先的市场份额，以持续支撑公司的市值表现？

答：您好！公司始终将技术创新作为可持续发展的基石，秉承“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念。研发中心下设软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程和系统集成七大共性技术模块，以高技术产品和垄断型产品为研发方向，结合高效的产品研发管理体系，将研发端、工艺端、产品端及市场端有机结合，促进技术成果的应用转化。

锡膏印刷设备属于 SMT 及 COB 产线的关键核心设备,一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及，对产品的良率有重大影响。公司锡膏印刷设备处于全球领先水平，产品性能已达到或超越国际顶尖厂商水平。随着 PCB 基板复杂度提高以及高价值 PCB 组装需求的持续增长,市场对锡膏印刷设备在稳定性、精度和智能化水平方面提出了更高的要求，从而带动了高端设备需求的显著提升。感谢您的关注！

9、高增业绩下，如何改善应收账款以提振市场信心？

答：您好！针对应收账款风险，公司的应对措施如下：1、加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款，专人跟进应收款催收，确保实时跟踪每笔应收账款情况；2、根据行业及客户性质将客户应收款进行分类管理，建立销售合同和回款档案，设专人进行日常登记和更新维

护，定期向销售责任人通报应收账款进展；3、将客户应收账款的回收情况纳入销售部门的考核体系，以提升回款率，降低应收账款回收的风险；4、关注主要应收账款客户的经营情况，定期评价客户信用状况，加强客户的风险评估，同时，进一步优化客户结构，提升客户群体信用质量。公司管理层将继续通过强化信用管理、优化客户结构与提升回款效率等多措并举，在保持业绩稳健增长的同时有效管控应收账款风险，以扎实的经营质量和稳健的资产结构提振市场信心。感谢您的关注！

10、如何巩固锡膏印刷设备的全球龙头地位以支撑市值？

答：您好！锡膏印刷设备属于 SMT 及 COB 产线的关键核心设备，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及，对产品的良率有重大影响。PCB 的应用领域伴随着工业领域自动化、智能化需求的不断提升，公司的锡膏印刷设备下游扩展至 AI 终端、汽车电子、AR/VR、智能穿戴、智能家居、安防等新兴行业，需求总量增加；依托新加坡子公司 GKGASIA 并由其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点，加上公司品牌和市场地位具有国际影响力，有助于拓展海外市场；随着 PCB 基板复杂度提高以及高价值 PCB 组装需求的持续增长，市场对锡膏印刷设备在稳定性、精度和智能化水平方面提出了更高的要求，从而带动了高端设备需求的显著提升，公司在锡膏印刷设备高端市场的占有率有望持续提升。感谢您的关注！

11、光模块专用设备放量预期与市占率提升路径？

答：您好！有关公司业务情况请关注公司披露的定期报告，感谢您的关注！

12、如何加速 CoWoS 等高端设备的商业化落地以提升估值

溢价？

答：您好！有关公司业务情况请关注公司披露的定期报告，感谢您的关注！

13、募投项目延期是否会影响高增长预期下的估值提升？

答：您好！公司募投项目延期是结合募投项目的投资进度和实际建设情况，经审慎评估后作出的决定，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。感谢您的关注！

14、公司账面现金充裕、负债率适中，是否考虑推出中期分红、回购方案或股权激励计划，以增强市场信心、释放业绩弹性信号？

答：您好！公司 2026 年中期暂无分红安排。公司始终重视对投资者的回报，坚持稳定的股利分配政策，并已连续多年进行现金分红，最近三个会计年度累计现金分红总额为 94,696,000.00 元。未来公司将结合经营状况、盈利水平及发展资金需要等因素，统筹考虑分红安排。感谢您的关注！

15、公司从单项冠军迈向多个单项冠军的研发布局下，下半年有哪些新品上市？半导体后道封装（固晶、键合、AOI 等）有无新的产品发布或客户验证里程碑？

答：您好！锡膏印刷设备不断巩固单项冠军的市场地位，紧跟工艺技术变化，提升高端市场及高精密印刷市场的占有率；点胶设备聚焦行业大客户与优势工艺场景，产品推陈出新，市场占有率稳步增长，实现应用领域突破，成功推出适用于隔离器、LENS 及透镜类的专用点胶设备；在封装领域，公司高精度固晶机赢得了下游通讯行业客户的认可，出货量稳步提升；多款封装设备成功切入 SIP、COB、COG、MiP 等细分领域；同时积极布局光通信领域，推出用于 COC/COS/TO 等产品的脉冲加热共晶机，储备了光模块领域

	专用设备技术。为适应并针对封装工艺向 CoWoS /CoWoP 的技术演进，前瞻性开发并储备了 3D 钢网印刷、植球、智能点锡等关键技术及产品。感谢您的关注！ 16、外销占比 22.23，东南亚、墨西哥等海外产能转移背景下，公司海外渠道与服务体系建设进展？海外收入占比未来三年的提升目标？ 答：您好！公司自 2007 年开始关注海外市场，在全球七十多个国家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区，公司品牌和市场地位具有国际影响力。公司目前已构建覆盖全球的营销网络与技术支持服务体系，依托新加坡子公司 GKG ASIA 并由其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点。未来公司还将继续加大海外市场的拓展力度，为公司的业绩做出贡献。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 15 日